

비밀

합작 개발 계약서

경기도 평택시 지제동 33번지 에 위치하고 있는 주식회사 아이피에스(이하 “갑”이라 칭한다.) 와 경기도 화성시 태안읍 능리 152-3번지에 위치하고 있는 아이램테크 주식회사(이하 “을” 이라 칭한다.) 2003년 11월 25일부로 다음과 같은 합작 개발 계약을 체결한다.

- 배 경 -

2003년 9월 1일부로 양사간에 합의한 비밀유지계약서를 근거로 “갑”과 “을”은 Dual Twin Arm이 장착된 반도체 장비용 Transfer Module(이하 “DTA-TM” 이라 칭한다.) 개발을 위하여 “갑”은 동 개발에 필연적으로 소요되는 재료비와 이에 필요한 각종 정보, 기술자료 및 Know-how 등을 제공하며, “을”은 이를 바탕으로 “갑”의 요구에 상응되는 DTA-TM 장비의 개발을 위하여 “을”이 소유하고 있는 제반기술과 Know-how를 제공함을 그 배경으로 한다.

- 내 용 -

제 1조 : (신의 성실 및 비밀유지)

- (1) “갑”과 “을”은 본 합작개발 계약내용을 성실하게 수행하여야 하며 본 합작개발 내용을 제 3자에게 공개하지 아니한다.
- (2) “갑”과 “을”은 본 합작개발계약 및 2003년 9월 1일부로 체결한 비밀유지계약내용에 포함되지 않은 사항 이 발생될 경우에는 상호 신의 및 신뢰를 바탕으로 성실하게 협의 후 시행하여야 한다.

제 2조 : (지적재산권)

- (1) “갑”과 “을”은 본 계약을 수행함에 있어 계약 체결이전에 발생한 지적재산권에 대하여는 각각의 소유로 한다.
- (2) 또한 본 계약체결이후 발생소지가 있는 지적재산권에 대하여는 양자 협의 하에 진행하되 공동 소유를 원칙으로 한다.

제 3조 : (개발 관련한 비용부담)

- (1) 동 장비 개발과 관련하여 직접적으로 소요되는 재료비는 “갑”이 부담하되 “을”은 사전에 이에 대한 소요명세서를 “갑”에게 제출하여 사전 승인을 받아야 한다.
- (2) 또한 “갑”은 동 개발에 소요되는 재료비를 현금 또는 현물로 “을”에게 제공한다.
- (3) 상기 (1)의 재료비를 제외한 인건비 및 기타 비용은 “을”이 부담하는 것으로 한다.

제 4조 : (개발비의 지급시기 및 지급방법)

- (1) 본 계약과 관련한 개발비중 “갑”이 “을”에게 지급할 총 비용은 순수 재료비에 국한한다.
- (2) 대금지급시기 및 방법은 동 계약체결일로부터 2주일 이내에 40%, 시스템 납품시 40%, Spec만족시 20%를 각각 지급하는 것으로 하며 “을”은 이를 위하여 “갑”에게 세금계산서를 발행하여 청구하고 “갑”은 세금계산서 발행일로부터 1개월 이내에 “을”이 제공하는 통장으로 입금하여야 한다.
- (3) 상기 제 3조 (2)에 의거 “갑”이 동 개발에 소요되는 재료비중 일부를 현물로 제공할 경우에는 동 계약금액에서 차감하는 것으로 하며 현물 제공 시에는 사전에 금액의 타당성 등에 대하여 “갑”과 “을”이 협의하여 진행하여야 한다.

제 5조 : (개발기간 및 시스템 납품)

- (1) 동 계약과 관련한 "DTA-TM" 개발기간은 계약체결일로부터 12개월간으로 한다.
- (2) “을”은 개발기간 이전인 2004년 3월 30일 이내에 시스템을 납품하여야 하며, 납품 후 “갑”이 동 시스템을 적용 소기의 목적달성에 달할 때까지는 계속적으로 서비스를 제공하여야 한다.

제 6조 : (개발완료 후 구매 및 판권 제한)

“갑”과 “을”은 동 계약에 의거 “DTA-TM” 의 개발이 완료될 경우 추가 구매 및 제3자의 판매와 관련하여 다음과 같이 합의한다.

- (1) “을”은 “갑”의 추가제작요청에 의거 시스템을 납품할 경우에는 제조 원가에 일정이윤을 더한 금액으로 공급하여야 한다. 단, 공급가는 최혜적인 조건으로서 “갑”과 협의하여 결정한다.

- (2) “을”은 동 계약과 관련한 “DTA-TM”(DTA-TM개발과 관련하여 특수 제작된 개발품 포함)의 판매는 반드시 “갑”에게만 할 수 있으며 제3자 판매는 “갑”을 통하여서만 이루어져야 한다. 단, Wafer Handling용 Twin End-Effector이외의 범용의 Dual Arm Vacuum Robot은 제외한다.
- (3) 개발 완료 후 “을”은 “갑”의 요청이 있을시 동 시스템의 제작에 필요한 기술을 전수하여야 하며(단, Wafer Handling용 Twin End-Effector이외의 범용의 Dual Arm Vacuum Robot은 제외한다.)이 경우 소요되는 인건비등은 “갑”에게 청구 할 수 있다.
- (4) 제3자에 대한 판매제한은 동 System납품에 대한 Spec만족일 (Sign-off일)로부터 5년간으로 한다.

제 7조 : (계약해지 및 재료비의 반환)

- (1) 동 계약의 해지는 “갑”과 “을”의 합의에 의하여 가능하다.
- (2) 만약 시스템 납품이전에 “을”의 귀책사유로 인하여 동 계약이 해지될 경우에는 “갑”이 해지일 이전에 지급한 재료비 및 현물 부담분을 지체없이 반환하여야 하며, “갑”의 귀책사유로 인하여 해지될 경우에는 기 지급한 부분의 반환의무는 면제 되는 것으로 한다.

제 8조 : (계약의 효력 및 준수사항)

- (1) 동 계약의 효력은 양자가 합의한 2003년 11월 25일 로 한다.
- (2) 계약체결 후 상기 각 조항에 대한 수정사항은 반드시 양자가 날인한 수정 계약서에 의해서만 가능하다.

제 9조 : (준거법)

본 계약서의 각 조항들은 대한민국 국내법에 따라 해석, 적용한다.

“갑”과 “을”은 본 계약이 체결되었음을 증명하고 성실히 이행하기 위하여 본 계약서 2부를 작성하여 상호 날인후 각 1부씩 보관한다.

2003년 11월 25일

“갑” : 아이피에스 주식회사

京畿道 平澤市 芝制洞 33

(株)아이피에스

代表理事 張 鎬

“을” : 아이램테크 주식회사

성기도 화성군 태안읍 능리 152-3

아이램테크(주)

대표이사 황

찬